

# 113 年「半導體封裝測試工程師」職能深化課程

課程地點：國立高雄科技大學半導體封裝測試類產業環境中心（高雄市三民區建工路 415 號）

課程日期：113 年 7 月 22 日（一）、113 年 7 月 23 日（二）、113 年 7 月 24 日（三），共 3 天

課程時間：09:00~18:00（報到時間為 08:50~09:00，中午休息時間為 12:00~13:00）

報名資格：全國各大專校院在學學生

報名連結：<https://forms.gle/3CCGfEe4bTcdHVpAA>

報名時間：即日起至 113 年 7 月 12 日（五）17:00 為止（如人數額滿將提前截止）

人數上限：實體 30 人（無線上授課）

活動內容：



報名連結

日期	時間	課程名稱	課程內容	授課教師
7/22 (一)	08:50~09:00	報到		
	09:00~12:00	失效模式實務	原理解說: 電性、表面測厚儀、SEM (普通教室)	高科大 電子工程系 劉志益教授
	12:00~13:00	午餐		
	13:00~17:00	失效模式實務	分組實作: 電性、表面測厚儀、SEM (無塵室)	高科大 電子工程系 劉志益教授
	17:00~18:00	Q & A		
7/23 (二)	08:50~09:00	報到		
	09:00~12:00	失效模式實務	分組實作: 電性、表面測厚儀、SEM (無塵室)	高科大 電子工程系 劉志益教授
	12:00~13:00	午餐		
	13:00~17:00	黏晶製程 打線製程 研磨製程	實作 (分組) (無塵室)	高科大 電子工程系 薛丁仁教授
	17:00~18:00	Q & A		
7/24 (三)	08:50~09:00	報到		
	09:00~12:00	黏晶製程 打線製程 研磨製程	實作 (分組) (無塵室)	高科大 電子工程系 薛丁仁教授
	12:00~13:00	午餐		
	13:00~17:00	黏晶製程 打線製程 研磨製程	實作 (分組) (無塵室)	高科大 電子工程系 薛丁仁教授
	17:00~18:00	Q & A		

**備註：**

1. 本次研習課程為期3天，需參與全程課程，且符合報名資格者（全國各大專校院在學學生），將於課程結束後核發研習時數證明。
2. 填寫並提交課程報名表單後即可視為報名成功，若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將提前另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名資格審核權，修改或變更活動內容及額滿提前截止報名之權利。
4. 本研習為免費課程，報名者無須負擔報名費。
5. 7/22、7/23、7/24 三天將於課前和課後提供交通接駁往返高鐵左營站、高雄火車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

**活動聯絡人：**

教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學

鄭經理-電話：(02) 2771-2171 分機 6012、Email：[clcheng@ntut.edu.tw](mailto:clcheng@ntut.edu.tw)

黃專員-電話：(02) 2771-2171 分機 6023、Email：[receivable0308@mail.ntut.edu.tw](mailto:receivable0308@mail.ntut.edu.tw)



報名連結